



科技硬件周报：关注 VIVO 首款折叠屏手机



行业动态

行业近况

上周(4/11-4/15)SW 电子指数下跌 4.2%, SW 通信指数下跌 5.7%, 恒生科技指数下跌 2.3%, 标普 500 指数下跌 2.1%, 纳斯达克指数下跌 2.6%, 费城半导体指数下跌 2.9%。

评论

半导体方面：上周，国内疫情继续受到投资者关注，上海封控已近半个月，苏州、南通等地部分地区也采取了暂时性封控措施。我们了解到上海区域的中芯国际、华虹集团等公司采取闭环管理保障生产运营，疫情对半导体的生产、物流以及供需方面具有负面影响。我们认为如果封控能够在 4 月底前基本解除影响仍然有限。我们看好国内半导体行业的长期发展趋势，建议关注华虹半导体、长电科技等制造公司；士兰微、斯达半导等功率器件公司；北方华创、芯碁微装、安集科技、立昂微、晶瑞电材、江丰电子等设备/材料公司；韦尔股份、圣邦股份、恒玄科技等 IC 设计公司。

消费电子方面：上周一，vivo 发布首款折叠屏手机 Xfold，定价 8,999 元起，该产品采用 UTG 盖板玻璃，航天级浮翼式铰链，搭载了高通最新旗舰 8Gen1 芯片，高通 3D 超声波指纹识别。至此，安卓主流品牌全部已发布折叠机旗舰产品，同时都在硬件协同、多屏互通方面开始全生态布局。我们看好折叠屏成为手机市场重要增量动力。我们建议投资人积极关注：1)

小米集团，安洁科技，比亚迪电子，长信科技（未覆盖），凯盛科技（未覆盖）等折叠屏品牌及相关供应链公司；2) 歌尔股份，舜宇光学，韦尔股份等 ARVR 相关产业链公司。

智能汽车及 AIoT 方面：上周，国务院常务会议部署促进消费政策举措，明确指出要鼓励汽车等大宗消费，各地不得新增汽车限购措施，将有助于恢复市场对汽车等大宗消费品销售的预期。我们认为，汽车电子板块自去年年底的高位至今已调整较多，但不改汽车智能化长期发展趋势。建议关注汽车智能化龙头德赛西威，封测公司晶方科技，智能座舱领域华阳集团，车联网通信模组龙头移远通信、广和通，车内高速通信相关瑞可达、电连技术。我们认为以“东数西算”、工业互联为代表的数字新基建有望推动云产业链全面受益，建议关注服务器头部厂商中科曙光，光纤光缆龙头中天科技，光模块厂商中际旭创，通信设备龙头厂商中兴通讯。

估值与建议

维持所覆盖公司评级、盈利预测、目标价不变。

风险提示

预览已结束，完整报告链接和二维码如下：

https://www.yunbaogao.cn/report/index/report?reportId=1_40505

